

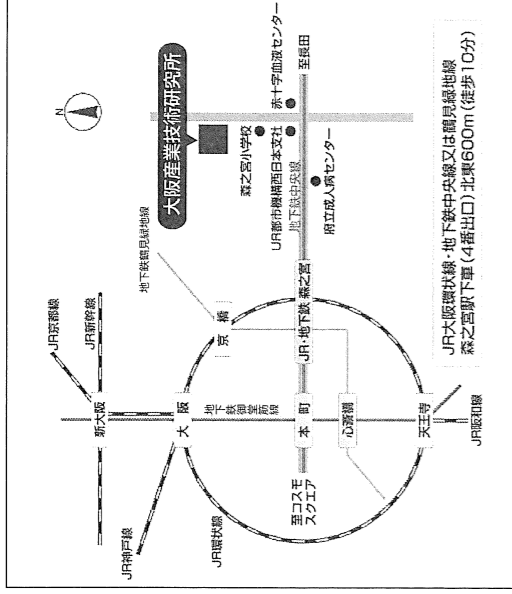
技術 第四十一回公開講座

エポキシ樹脂および関連技術の最近の進歩

会場		〔Ⅰ〕 大阪の部		会場：大阪産業技術研究所 大講堂	
期 日		第1日：平成29年7月27日(木)		第2日：平成29年7月28日(金)	
受講受付		8時30分より		8時30分より	
時 間	テ ー マ	講 師	テ ー マ	講 師	
9時25分	会長挨拶	当協会会長 東京医科歯科大学名誉教授 工学博士 宮入 裕夫氏			
9時30分					
9時30分	樹脂硬化収縮率、硬化物応力測定方法 (株)アクロエッジが販売、普及させている樹脂硬化収縮率、硬化物応力測定装置(Custron)の樹脂硬化収縮率測定方法がJIS化される。今回はその新しい手法の概要について説明する。	株式会社アクロエッジ 代表取締役 中宗 憲一氏	木質リグニン由来エポキシ樹脂 木質バイオマスから抽出したリグニンを利用したエポキシ樹脂及び硬化剤の特徴と、その応用の可能性について解説する。	株式会社日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ 先端材料研究部 主任研究員 工学博士 香川 博之氏	
10時30分					
10時30分	電子材料分野におけるエポキシ樹脂の最新の動向 近年の電子材料分野における技術動向と、その要求特性に対応したエポキシ樹脂開発のアプローチを紹介する。	新日鉄住金化学株式会社 エポキシ樹脂材料センター 研究員 工学博士 大村 昌己氏	ゴム変性エポキシ系接着剤の破壊機構 ゴム変性エポキシ系接着剤により接着された接着継手の破壊じん性ならびに疲労強度特性について述べる。	大阪教育大学 技術教育講座 特任教授 工学博士 今中 誠氏	
11時30分					
休 憩		休 憩		休 憩	
11時40分	エポキシ樹脂のサーマルショック試験及びヒートサイクル試験とその評価 エポキシ樹脂は脆くて、かつ熱伝導率が低く温度勾配を作りやすいため、熱衝撃あるいは低サイクルの熱疲労に弱い。その評価試験法と、破壊メカニズムの解析事例について解説する。	東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 教授 工学博士 久保内 昌敏氏	Panel Level Package製造 工程中の反り挙動 Fan-out package を効率よく作製するPanel Level Packageについて、行程中の反り挙動を検証した。	リンテック株式会社 研究所 新素材研究部 デバイス材料研究室 主任 菊池 和浩氏	
12時40分					
12時40分 13時15分	昼 食	昼 食	昼 食	昼 食	
13時15分	低温硬化対応のエポキシ樹脂硬化促進剤の開発及びそのビスマレイミドへの適用について 近年求められている低温硬化対応のリン系硬化促進剤の紹介と、その硬化促進剤のビスマレイミド用への適用について説明する。	北興化学工業株式会社 化成成品研究所 主席研究員 大橋 賢治氏	F O-W L Pの動向と進化する封止材技術の適用 住友ベークライト(株)のF O-W L P向け封止材技術の紹介。	住友ベークライト株式会社 電子デバイス材料研究所 研究部 主席研究員 森 弘就氏	
14時15分					
休 憩		休 憩		休 憩	
14時25分	自己修復性を有する炭素繊維／エポキシ樹脂積層材料の開発 マイクロカプセルを用いて自己修復性を付与した炭素繊維／エポキシ樹脂積層材料の開発状況と課題について解説する。	富山県立大学 工学部 機械システム 工学科 教授 工学博士 真田 和昭氏	電気絶縁(封止材)用フィラーの変遷と技術動向 電気絶縁用フィラーの変遷と最近の技術・製品開発動向について、半導体封止用途を中心に紹介する。	株式会社龍森 開発研究情報部 執行役員 工学博士 中島 信哉氏	
15時25分					
15時25分	接着剤接合界面の特性評価と接着メカニズム 金属、樹脂、CFRP等の異種材料接合における界面特性評価方法の国際標準化と接合メカニズムに関する研究について述べる。	国立研究開発法人 産業技術総合研究所 上級主任研究員 工学博士 堀内 伸氏	ZrO <sub>2</sub> ナノ微粒子を用いたエポキシ透明樹脂の高屈折率化 ZrO <sub>2</sub> ナノ微粒子をエポキシ樹脂中にナノ分散させることによって嵩透明かつ高屈折率なハイブリッドバルク材料を合成する手法について講演する。	山形大学 学術研究院 有機材料システム分野 教授 工学博士 川口 正剛氏	
16時25分					

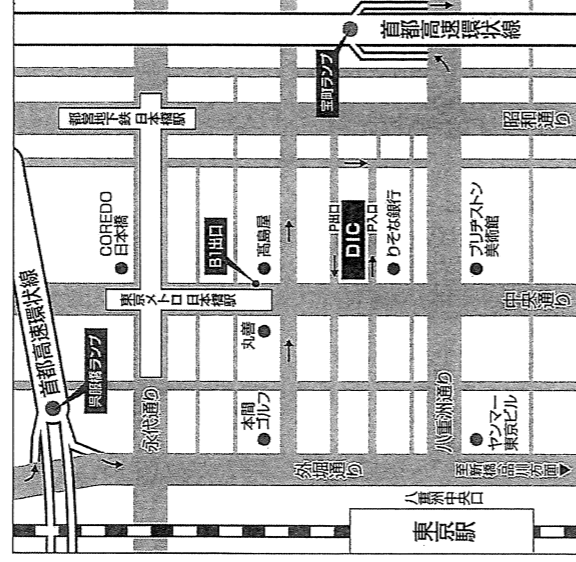
会場		〔Ⅱ〕 東京の部		会場：DIC株式会社 本社 大会議室	
期 日		第1日：平成29年8月1日(火)		第2日：平成29年8月2日(水)	
受講受付		8時30分より		8時30分より	
時 間	テ ー マ	講 師	テ ー マ	講 師	
9時25分	会長挨拶	当協会会長 東京医科歯科大学名誉教授 工学博士 宮入 裕夫氏			
9時30分					
9時30分	電子材料分野におけるエポキシ樹脂の最新の動向 近年の電子材料分野における技術動向と、その要求特性に対応したエポキシ樹脂開発のアプローチを紹介する。	新日鉄住金化学株式会社 エポキシ樹脂材料センター 研究員 工学博士 大村 昌己氏	低温硬化対応のエポキシ樹脂硬化促進剤の開発及びそのビスマレイミドへの適用について 近年求められている低温硬化対応のリン系硬化促進剤の紹介と、その硬化促進剤のビスマレイミド用への適用について説明する。	北興化学工業株式会社 化成成品研究所 主席研究員 大橋 賢治氏	
10時30分					
10時30分	木質リグニン由来エポキシ樹脂 木質バイオマスから抽出したリグニンを利用したエポキシ樹脂及び硬化剤の特徴と、その応用の可能性について解説する。	株式会社日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ 先端材料研究部 主任研究員 工学博士 香川 博之氏	Panel Level Package製造 工程中の反り挙動 Fan-out package を効率よく作製するPanel Level Packageについて、行程中の反り挙動を検証した。	リンテック株式会社 研究所 新素材研究部 デバイス材料研究室 主任 根津 裕介氏	
11時30分					
休 憩		休 憩		休 憩	
11時40分	エポキシ樹脂のサーマルショック試験及びヒートサイクル試験とその評価 エポキシ樹脂は脆くて、かつ熱伝導率が低く温度勾配を作りやすいため、熱衝撃あるいは低サイクルの熱疲労に弱い。その評価試験法と、破壊メカニズムの解析事例について解説する。	東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 教授 工学博士 久保内 昌敏氏	電気絶縁(封止材)用フィラーの変遷と技術動向 電気絶縁用フィラーの変遷と最近の技術・製品開発動向について、半導体封止用途を中心に紹介する。	株式会社龍森 開発研究情報部 執行役員 工学博士 中島 信哉氏	
12時40分					
12時40分 13時15分	昼 食	昼 食	昼 食	昼 食	
13時15分	ZrO <sub>2</sub> ナノ微粒子を用いたエポキシ透明樹脂の高屈折率化 ZrO <sub>2</sub> ナノ微粒子をエポキシ樹脂中にナノ分散させることによって嵩透明かつ高屈折率なハイブリッドバルク材料を合成する手法について講演する。	山形大学 学術研究院 有機材料システム分野 教授 工学博士 川口 正剛氏	樹脂硬化収縮率、硬化物応力測定方法 (株)アクロエッジが販売、普及させている樹脂硬化収縮率、硬化物応力測定装置(Custron)の樹脂硬化収縮率測定方法がJIS化される。今回はその新しい手法の概要について説明する。	株式会社アクロエッジ 代表取締役 中宗 憲一氏	
14時15分					
休 憩		休 憩		休 憩	
14時25分	F O-W L Pの動向と進化する封止材技術の適用 住友ベークライト(株)のF O-W L P向け封止材技術の紹介。	住友ベークライト株式会社 電子デバイス材料研究所 研究部 主席研究員 森 弘就氏	ゴム変性エポキシ系接着剤の破壊機構 ゴム変性エポキシ系接着剤により接着された接着継手の破壊じん性ならびに疲労強度特性について述べる。	大阪教育大学 技術教育講座 特任教授 工学博士 今中 誠氏	
15時25分					
15時25分	接着剤接合界面の特性評価と接着メカニズム 金属、樹脂、CFRP等の異種材料接合における界面特性評価方法の国際標準化と接合メカニズムに関する研究について述べる。	国立研究開発法人 産業技術総合研究所 上級主任研究員 工学博士 堀内 伸氏	自己修復性を有する炭素繊維／エポキシ樹脂積層材料の開発 マイクロカプセルを用いて自己修復性を付与した炭素繊維／エポキシ樹脂積層材料の開発状況と課題について解説する。	富山県立大学 工学部 機械システム 工学科 教授 工学博士 真田 和昭氏	
16時25分					

(大阪会場) 大阪産業技術研究所 大講堂  
〒536-8553 大阪市城東区森之宮 1-6-50  
TEL 06-6963-8011 ~ 3



(交通) J R大阪環状線・地下鉄中央線又は鶴見緑地線  
森之宮駅下車(4番出口)北東 600m(徒歩 10分)

(東京会場) DIC 株式会社 本社 大会議室  
〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7 ディーアイシービル  
TEL 03-6733-3000



エポキシ樹脂技術協会主催  
第41回公開技術講座

大阪 会場申込書 会員有料分・一般(非会員)

(左の会員・非会員の該当を○で囲んで下さい。)

貴社名		聴講者ご氏名	同左所属部課	聴講料 円
聴講券領収証送り先(1)	(〒 - ) 電話			銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成29年 月 日 聴講料請求書 要 不要
聴講券領収証送り先(2)	(〒 - ) 電話			講演要旨集事前配布 (送料受取人払い) 要 不要

2名以上の申し込みで聴講券の発行先が2ヵ所になる場合は聴講者氏名に(1)又は(2)を附して区別して下さい。

エポキシ樹脂技術協会主催  
第41回公開技術講座

エポキシ樹脂および関連  
技術の最近の進歩

大阪：平成 29 年 7 月 27 日 (木)・28 日 (金)  
大阪産業技術研究所 大講堂

東京：平成 29 年 8 月 1 日 (火)・2 日 (水)  
DIC 株式会社 本社 大会議室

主催 エポキシ樹脂技術協会

東京都新宿区市ヶ谷砂土原町 1-2  
〒162-0842 タイホービル 102号  
電話 03-3260-1721  
FAX 03-3235-9012  
URL : <http://epoxygk.world.coocan.jp>

会員お申込要領

1. 会員聴講料

会員区分	無料分	有料分
正会員	東京または大阪 1名 無料	18,000円
維持会員及特別維持会員	東京・大阪を合せて 2名 無料	18,000円

2. 申込方法 (締切り) 大阪会場 7月25日  
東京会場 7月28日

1) 無料分のお申込

各会員の当協会担当者(窓口)宛にお送りした会  
員無料分申込書に御記入の上協会宛お送り下さい。  
折返し聴講券をお送りします。

2) 有料分のお申込

聴講料(18,000円)以外は一般(非会員)と同じ  
です。右の一般(非会員)申込要領をご参照  
下さい。

※講演要旨集の事前配布

聴講申込みの方の内、希望者には送料受取人払い  
の宅配便にて講演要旨集の事前配布を行います。  
ご希望の方は申込み書の所定欄に記入して下さい。

エポキシ樹脂技術協会主催  
第41回公開技術講座

東京 会場申込書 会員有料分・一般(非会員)

(左の会員・非会員の該当を○で囲んで下さい。)

貴社名		聴講者ご氏名	同左所属部課	聴講料 円
聴講券領収証送り先(1)	(〒 - ) 電話			銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成29年 月 日 聴講料請求書 要 不要
聴講券領収証送り先(2)	(〒 - ) 電話			講演要旨集事前配布 (送料受取人払い) 要 不要

2名以上の申し込みで聴講券の発行先が2ヵ所になる場合は聴講者氏名に(1)又は(2)を附して区別して下さい。

一般(非会員)お申込要領

1. 聴講料

35,000円(講演要旨集代、昼食代を含む)

2. 申込方法 (締切り) 大阪会場 7月25日  
東京会場 7月28日

本案内状の申込書(東京、大阪、別々の用紙にご  
記入下さい)を協会宛郵送又はFAXにて連絡の  
上、聴講料を指定銀行に振込んで下さい。折返し  
聴講券及び領収書をお送り致します。開催前1週  
間以内にお振込の場合は聴講券及び領収書は当日  
会場受付にてお受け取り下さい。聴講料の請求書  
入用の場合は聴講申込書にその旨ご記入下さい。  
また、当協会のホームページからも申込できます。  
(<http://epoxygk.world.coocan.jp>)

3. 申込先

東京都新宿区市ヶ谷砂土原町 1-2  
〒162-0842 タイホービル 102号

エポキシ樹脂技術協会 電話 03(3260)1721  
FAX 03(3235)9012

4. 振込先

みずほ銀行市ヶ谷支店 普通口座 1124935

エポキシ樹脂技術協会

尚、お振込の際は個人名でなく会社名を入れてお  
願い致します。個人名だけでは確認が困難で聴講  
券の発送に支障をきたす場合があります。

5. ご注意

聴講料の払戻しは致しませんので、お申込者にご  
都合のある場合は、代理の方が参加して下さい。  
また、講演要旨集は別売致しますので、ご了承下さい。